



# Registerauszug zum Aktenzeichen 10 2017 131 354.0

Stand am 21.05.2024  
(letzte Aktualisierung in DPMAregister am 12.04.2024)

---

Es bestehen folgende Eintragungen:

---

## Stammdaten

---

- [-----] **Schutzrechtsart:** Patent
- [-----] **Status:** Anhängig/in Kraft
- [21] **Aktenzeichen DE:** 10 2017 131 354.0
- [54] **Bezeichnung/Titel:** Ein Halbleiterbauelement mit breitem Bandabstand und ein Verfahren zum Bilden eines Halbleiterbauelements mit breitem Bandabstand
- [51] **IPC-Hauptklasse:** H01L 29/78 (2006.01)
- [51] **IPC-Nebenkategorie(n):** H01L 29/36 (2006.01);H01L 29/161 (2006.01);H01L 21/336 (2006.01)
- [22] **Anmeldetag DE:** 27.12.2017
- [43] **Offenlegungstag:** 27.06.2019
- [71/  
73] **Anmelder/Inhaber:** Infineon Technologies AG, 85579 Neubiberg, DE
- [-----] **Erfinder:** Lutz, Josef, 09126 Chemnitz, DE; Rupp, Roland, 91207 Lauf, DE; Schulze, Hans-Joachim, 82024 Taufkirchen, DE;
- [74] **Vertreter:** 2SPL Patentanwälte PartG mbB Schuler Schacht Platzer Lehmann, 81373 München, DE
- [10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE102017131354A1
- [-----] **Zustellanschrift:** 2SPL Patentanwälte PartG mbB Schuler Schacht Platzer Lehmann, 81373 München, DE
- [-----] **Fälligkeit:** Jahresgebühr für das 8. Jahr/ 31.12.2024
- [-----] **Zuständige Patentabteilung:** 33
- [56] **Entgegenhaltungen/Zitate:** DE000003823795A1 (DE 38 23 795 A1); US020130221401A1 (US 2013 / 0 221 401 A1); DE102016111844A1 (DE 10 2016 111 844 A1); EP000000103138A2 (EP 0 103 138 A2); DE112016006385T5 (DE 11 2016 006 385 T5)
-

- [43] **Erstveröffentlichungstag:** 27.06.2019
- [-----] **Anzahl der Bescheide:** 3
- [-----] **Anzahl der Erwiderungen:** 2
- [-----] **Erstmalige Übernahme in DPMRegister:** 27.06.2019
- [-----] **Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMRegister:** 27.06.2019; 06.03.2020; 09.03.2021; 01.12.2021; 10.03.2022; 09.03.2023; 01.12.2023; 29.02.2024; 28.03.2024; 12.04.2024

## Verfahrensdaten

---

### Vorverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Die Anmeldung befindet sich in der Vorprüfung
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 27.12.2017

### Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsantrag wirksam gestellt
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 27.12.2017
- [-----] **Antrag Dritter:** Nein
- [-----] **Eingangstag:** 27.12.2017

### Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsbescheid
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 16.05.2018

### Vorverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Vorverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Das Vorverfahren ist abgeschlossen
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 11.12.2018

### Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Erwidern auf Prüfungsbescheid
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 19.02.2019

### Publikationen

- [-----] **Verfahrensart:** Publikationen
- [-----] **Verfahrensstand:** Offenlegungsschrift
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 27.06.2019
- [-----] **Heftnummer:** 26
- [-----] **Jahr:** 2019

- [-----] **Veröffentlichungsdatum:** 27.06.2019
- [-----] **Publikationsart:** Schriften
- [-----] **Teil:** Teil 2
- [10] **Veröffentlichte DE-Dokumente:** DE102017131354A1

#### Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsbescheid
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 30.11.2023
- [-----] **Tag der Aktualisierung des Verfahrens:** 01.12.2023

#### Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Erwiderung auf Prüfungsbescheid
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 26.03.2024
- [-----] **Tag der Aktualisierung des Verfahrens:** 28.03.2024

#### Prüfungsverfahren

- [-----] **Verfahrensart:** Prüfungsverfahren
- [-----] **Verfahrensstand:** Prüfungsbescheid
- [-----] **Verfahrensstandstag:** 11.04.2024
- [-----] **Tag der Aktualisierung des Verfahrens:** 12.04.2024